副總、各位長官大家好

我是此次基層實務報告，報告人員葉俊偉

這是我的專案題目 環形垂直連續電鍍機生產參數轉至開發

報告大綱分為 : 介紹專案背景->動機->目的->分析->預期結果->目前心得

環形垂直連續電鍍機UVCP

本次專案機台位於樹林一廠二課5F填孔電鍍(PTH)區

機型代號為MIFI

廠商是亞朔

機台主要目的是將雷射鑽孔或機械鑽孔所產生之孔洞進行

電鍍銅流程以達到填孔電鍍的目的

機台運作流程如下圖

去程: 半成品入料->經由電鍍流程->出料

返程: 清洗掛架 進行下一批鍍銅準備

填孔電鍍是指在半成品表面孔洞鍍銅，使得各層電路藉由孔洞上的銅層連通，

形成有效電子電路:

好處在於:能夠改變傳統電路設計，類似將傳統平房改建成大樓，

在相同電路的情況，縮小其面積，也能提升後製成良率(錫膏製程)

鍍銅即是將半成品至於電解液裡用電流產生電解反應把銅鍍於鈑件上

主成分為: 再透過有機添加物 輔助鍍銅

填孔電鍍流程:

通則:半成品水洗->依照產品特性(ABF 模種)->酸洗

->微蝕

->介面活性劑=>二次水洗->預浸(避免PH直若差太大)->前緩衝曹(避免鍍銅曹電流拉不起來) ->4個鍍銅曹(每個鍍銅曹有前後電流 前為CO 後為SO )->後緩衝->水洗->風刀->下製程

-

又因為為了Cycle time reduction CTR 製程及研發工程師盡量將一些影響鍍銅銅厚的變數定為常數(藥液、溫度、線速、壓力等等)，因此主要透過操作鍍銅前後電流去控制銅厚(電流太大銅變厚、電流太小銅變薄)

因此收集機台相關資訊能夠有效提供製程及研發相關工程師改善及提升製程良率

本專案首先 進行uvcp機台生產參數 收集各項機台零件生產參

數

接著收吉機台生產狀況 將機台資訊轉為 判定生產狀態

針對機台設備異常進行轉志 像是噴壓異常 整流器等等

最後轉至機台生產條件 由yip/研發 所制定的產品生產條件

目標 將資訊彙整 提供線上報表

提供異常通知mail包括機台異常以及生產條件異常

提供單日機台異常及生產條件日報

首先進行現狀分析

接著進行異常分析